

## 炬芯科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”），系炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯科技”）的全资子公司，本次担保不存在关联关系。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公司提供担保额度不超过人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，合肥炬芯均按期履行付款义务，公司未实际承担担保责任，因此公司及子公司的担保余额为人民币 0 元。

- 本次担保是否有反担保：否

- 本次担保无需经股东大会审议。

### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。全资子公司合肥炬芯芯片研发完成后，需要委托供应商和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（以下简称“和舰科技”）进行晶圆代工厂流片生产。为了支持合肥炬芯的业务发展，提升公司整体效益，董事会同意公司为合肥炬芯在 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间的付款义务提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。目前公司尚未签署担保协议，具体内容以实际与和舰科技签署的担保协议为准，公司与和舰科技不存在关联关系。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

中文名称：合肥炬芯智能科技有限公司

成立时间：2016年12月1日

注册资本：人民币10,300.00万元

注册地：合肥市新站区铜陵北路与北二环交口万国大厦办1101室

统一社会信用代码：91340100MA2N4LYE11

法定代表人：刘凤美

股东构成及控制情况：炬芯科技持股100%

经营范围：集成电路、通信系统产品、计算机周边系统产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电整合系统产品的研发、设计、测试、销售及技术服务；上述产品的软件材料、电路模块、零件及周边产品的设计、测试、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：人民币万元

财务情况	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2022年12月31日/2022年度（经审计）
资产总额	18,044.84	16,170.48
净资产	15,038.53	11,840.36
营业收入	14,677.68	14,495.99
净利润	1,398.17	632.03
负债总额	3,006.30	4,330.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,271.25	612.53

截止本公告日，合肥炬芯不存在被列为失信被执行人的情况。

影响被担保人合肥炬芯偿债能力的重大或有事项：无。

## 三、 拟签订的担保协议主要内容

合肥炬芯委托供应商和舰科技进行晶圆代工厂流片生产，公司同意为合肥炬芯在 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间的付款义务提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证；

保证期间：3 年，自主债务的履行期限届满之日起分别计算。如合肥炬芯与和舰科技协商一致调整债务金额及债务履行期限的，保证人仍同意按照本协议约定对调整后的债务提供连带责任保证；

截至本公告披露之日，公司尚未签署担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。公司与和舰科技没有关联关系。

#### **四、 担保的原因及必要性**

上述担保系根据子公司实际业务需要，为满足子公司项目发展需求而进行的，有利于保证子公司项目正常建设和业务顺利开展。上述担保的被担保方为公司全资子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。

同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

#### **五、 董事会意见**

董事会认为：公司本次为子公司提供担保事项是为满足子公司日常生产经营的需要，有利于促进子公司业务开展且风险整体可控。上述担保不会损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

#### **六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露之日，合肥炬芯均按期履行付款义务，炬芯科技未实际承担担保责任，因此公司及子公司的担保余额为人民币 0 元。公司及控股子公司均未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日